



Docket No.: MUH-12876

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, Alexandria, VA 22313 20231.

By: 

Date: January 23, 2004

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applic. No. : 10/718,310
Applicant : Bernhard Kowalski, et al.
Filed : November 20, 2003

Docket No. : MUH-12876
Customer No.: 24131

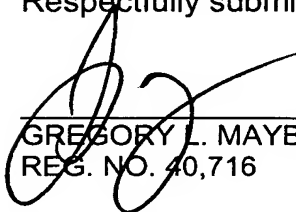
CLAIM FOR PRIORITY

Mail Stop: Missing Parts
Hon. Commissioner for Patents,
Alexandria, VA 22313-1450
Sir:

Claim is hereby made for a right of priority under Title 35, U.S. Code, Section 119, based upon the German Patent Application 102 54 160.4 filed November 20, 2002.

A certified copy of the above-mentioned foreign patent application is being submitted herewith.

Respectfully submitted,



GREGORY L. MAYBACK
REG. NO. 40,716

Date: January 23, 2004

Lerner and Greenberg, P.A.
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100
Fax: (954) 925-1101

GLM/av

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 102 54 160.4

Anmeldetag: 20. November 2002

Anmelder/Inhaber: Infineon Technologies AG, München/DE

Bezeichnung: Transistorarray und damit hergestellte
Halbleiterspeicheranordnung

IPC: H 01 L 27/108

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 14. November 2003
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the President of the German Patent and Trademark Office.

Wehner

MÜLLER • HOFFMANN & PARTNER – PATENTANWÄLTE

European Patent Attorneys – European Trademark Attorneys

Innere Wiener Strasse 17
D-81667 München

Anwaltsakte:	12223	Ko/Ant/mk
Anmelderzeichen:	2002P08678 (2002 E 08676 DE)	20.11.2002

Infineon Technologies AG

St.-Martin-Straße 53
81669 München

**Transistorarray und damit hergestellte
Halbleiterspeicheranordnung**

Beschreibung

Transistorarray und damit hergestellte Halbleiterspeicheranordnung

5

Die Erfindung betrifft ein Transistorarray aus vertikalen FET-Transistoren, die jeweils in Form vertikaler und in Lateralrichtung parallel laufender Abschnitte von aktiven Stegen aus Halbleiterbereichen in die Tiefe eines Substrats ausgebildet sind und bei denen ein Kanalbereich von die Gateelektroden bildenden Gatestreifen umgeben ist, die entlang den aktiven Stegabschnitten laufen und gleichzeitig Wortleitungen für ein dem Transistorarray zugeordnetes Array aus Halbleiterspeicherzellen bilden, wobei Wortleitungskontakte, wenigstens einen Teil der Wortleitungen elektrisch mit Metallbahnen einer das Transistorarray überlagernden Metallebene verbinden. Die Erfindung betrifft auch eine damit hergestellte Halbleiterspeicheranordnung, insbesondere einen DRAM-Speicher.

20

Ein Transistorarray mit den oben genannten Merkmalen ist aus US 5 519 236 bekannt.

25

Die andauernde Tendenz, Halbleiterspeicheranordnungen, wie DRAMs immer weiter zu verkleinern, hat dazu geführt, dass man die Speicherkondensatoren der Speicherzellen und die zugehörigen Transistoren als vertikale Elemente in die Tiefe des Halbleitersubstrats hinein baut. Auf diese Weise tragen die vertikal ausgebildeten FET-Transistoren dazu bei, dass Halbleiterspeicheranordnungen mit einer Geometrie der Speicherzelle von $F = 70 \text{ nm}$ und kleiner realisiert werden und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit der vertikalen FET-Transistoren beibehalten werden konnte.

30

35

Dazu wurden in einem entsprechenden Prozess mit Silizium ausgefüllte parallel laufende aktive Stege in einer Breite

von 0,5 - 1 F gebildet, in denen Bulk-, Source- und Drainelektroden der vertikalen FET-Transistoren liegen. Diese aktiven Stege werden stirnseitig jeweils durch tiefe Gräben (englisch: "deep trenches") begrenzt. An der Oberseite der tiefen Gräben befindet sich von Isoliermaterial gekapseltes Polysilizium oder nur Isolationsmaterial. An den beiden Seiten jedes aktiven Stegs befinden sich eine Gateelektrode jedes Transistors bildende Gatestreifen, gebildet durch einen vertikal geätzten Spacer, die ihrerseits als Wortleitung für die zugehörigen Halbleiterspeicherzellen dienen. Dabei beträgt die Dicke der Wortleitung annähernd 0,2 F und ihre vertikale Abmessung annähernd 5 F. Das obere Ende der Wortleitungsspacer liegt einige 10 nm unterhalb der Oberseite des aktiven Stegs. Gatekontakte, so genannte CS-Kontakte stellen den Kontakt zur Wortleitung her. Zur Herstellung der CS-Kontakte wird der aktive Steg mit einem sehr kleinen Ausschnitt quer zur Laufrichtung des aktiven Stegs versehen. Durch diesen Ausschnitt wird die vertikale Höhe des aktiven Stegs verringert und an dieser Stelle der Kontakt zur Wortleitung hergestellt.

Das Problem dabei ist, dass die Wortleitungskontakte und die Wortleitungen elektrisch von dem aktiven Steg und von anderen Bereichen oder Elementen des Transistorarrays bzw. den Halbleiterspeicherzellen isoliert sein müssen, damit z.B. auch negative Spannungen an die Wortleitung angelegt werden können. Es ist dabei nicht möglich, die Wortleitung von den aktiven Stegen räumlich zu separieren, um etwa einen Kontakt herzustellen. Der Grund liegt darin, dass die Wortleitungen ohne eigene Maskenebene hergestellt werden und an die aktiven Stege gekoppelt sind.

Die vorliegende Erfindung zielt auf die Lösung des obigen Problems und schlägt eine Struktur zur Isolation der Wortleitungskontakte bzw. CS-Kontakte sowie der Wortleitungen von

den übrigen Bereichen des Transistorarrays bzw. des zugeordneten Halbleiterspeicherzellenarrays vor.

Gemäß einem ersten Aspekt dieser Erfindung sind die Wortleitungskontakte jeweils durch eine in einem in die Tiefe des aktiven Stegs gehenden tiefen Graben vorgesehene Isolation gegenüber den anderen Elementen isoliert, wobei die tiefen Gräben mit derselben Struktur gebildet sind, wie die tiefen Gräben, die sonst Speicher Kondensatoren im Array der Halbleiterspeicherzellen bilden mit Ausnahme eines vergrabenen Anschlusses, der den aktiven Steg im Speicherzellenarray mit in der Tiefe des Substrats liegendem Polysilizium verbindet und der in den tiefen Gräben der Wortleitungskontakte weggelassen ist. An diesem den Wortleitungskontakt aufweisenden tiefen Graben wird demnach der im Speicherzellenfeld als Drainkontakt fungierende vergrabene Anschluss ("buried strap") zwischen dem tief liegenden Polysilizium und dem aktiven Steg weggelassen, so dass der tiefere Bereich des tiefen Grabens am Wortleitungskontakt nicht, wie sonst im Speicherzellenfeld, als Kondensator fungiert. Auf diese Weise werden im Prozess zur Herstellung der Wortleitungskontakte keine neuen Masken oder Strukturen benötigt.

Bevorzugt ist der tiefe Graben unterhalb des Wortleitungskontaktes mit Isoliermaterial gefüllt.

Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung, bei dem das Transistorarray mit dem Array der Halbleiterspeicherzellen in einer gemeinsamen ersten Halbleiterwanne in dem Substrat angeordnet ist, werden alle Wortleitungen mit den Wortleitungs- bzw. CS-Kontakten zur Metallebene in eine von der ersten Halbleiterwanne isolierte separate zweite Halbleiterwanne desselben Leitungstyps geführt und stehen dort durch die Wortleitungskontakte mit den Metallbahnen der Metallebene in Kontakt.

Gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel dieses Transistorarrays sind die Wortleitungen zu beiden Seiten tragenden aktiven Stege innerhalb der zweiten Halbleiterwanne von den entsprechenden Stegabschnitten außerhalb der zweiten Halbleiterwanne durch oxidumhüllte Säulen innerhalb von durch die Stege gehenden tiefen Gräben isoliert, die an der Schnittstelle der zweiten Halbleiterwanne zu einem sie umgebenden Halbleiterbereich entgegengesetzten Leitungstyps ausgebildet sind, wobei die tiefen Gräben mit derselben Struktur gebildet sind, wie die tiefen Gräben, die sonst Speicherkondensatoren im Array der Halbleiterspeicherzellen bilden, mit Ausnahme eines vergrabenen Anschlusses, der den aktiven Steg im Speicherzellenarray mit in der Tiefe des Substrats liegendem Polysilizium verbindet und der in den tiefen Gräben an der Schnittstelle der zweiten Halbleiterwanne zu dem sie umgebenden Halbleiterbereich entgegengesetzten Leitungstyps weggelassen ist.

Bei diesem bevorzugten Ausführungsbeispiel können die FET-Transistoren n-Kanal-Transistoren sein, wobei die erste und die zweite Halbleiterwanne vom p-Typ sind. Die vorgeschlagene Struktur des Transistorarrays kann so ausgeführt sein, dass die Dicke der die Halbleiterbereiche bildenden aktiven Stege 0,5 - 1 F, die Länge jedes einen n-Kanal-Transistor bildenden Abschnitts der aktiven Stege 2-3 F, die Dicke der Wortleitungen zu beiden Seiten der Stege annähernd 0,2 F und ihre vertikale Tiefe annähernd 5 F betragen, wobei hier z.B. $F = 70$ nm ist.

Eine bevorzugte Anwendung des erfindungsgemäßen Transistorarrays ist eine Halbleiterspeicheranordnung, bei der jeder Speicherzelle des Speicherarrays ein derartiger vertikaler FET-Transistor zugeordnet ist. Eine derartige Halbleiterspeicheranordnung ist insbesondere ein DRAM-Speicher.

Die obigen Merkmale und weitere Vorteile werden aus den beiliegenden Patentansprüchen und der nachfolgenden Beschreibung deutlich, die sich auf die beiliegende Zeichnung bezieht. Die Zeichnungsfiguren zeigen im einzelnen:

5

Fig. 1 schematisch und perspektivisch eine bekannte vertikale Transistorstruktur mit einer einen Kanalbereich in Form von Gatestreifen umgebenden Gateelektrode;

10

Fig. 2 einen Querschnitt durch einen Abschnitt der in Fig. 1 gezeigten Struktur in die Tiefe des Substrats hinein, um die Anordnung der jedem Transistor zugeordneten, in vertikal ausgebildeten tiefen Gräben, gebildeten Speicherkondensatoren zu veranschaulichen;

15

Fig. 3 eine schematische Layoutansicht der in Fig. 2 gezeigten Struktur;

20

Fig. 4A eine Layoutansicht eines ersten Ausführungsbeispiels einer erfindungsgemäß gestalteten Kontaktierung eines Wortleitungs- oder CS-Kontakts mit der Wortleitung und der darüber liegenden Metallebene, die die Isolation des Wortleitungskontakts durch einen tiefen Graben veranschaulicht;

25

Fig. 4B eine Querschnittansicht, die die vertikale Struktur des in Fig. 4A gezeigten ersten Ausführungsbeispiels des Wortleitungs- bzw. CS-Kontakts veranschaulicht und

30

Fig. 5 eine Layoutansicht eines Transistor- und Speicherzellenarrays mit Wortleitungskontakten gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

35

Vor der nachstehenden Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele eines erfindungsgemäßen Transistorarrays bzw. einer dieses verwendenden Halbleiterspeicheranordnung werden nun anhand der Fig. 1 bis 3 ein bekanntes Konzept eines Transistorarrays mit vertikalen FET-Transistoren mit umlaufendem Gatestreifen und die dabei auftretenden Probleme beschrieben (vgl. US 5 519 236).

Die perspektivische Darstellung der Fig. 1 zeigt einen Abschnitt eines einen einzelnen Transistor T bildenden aktiven Stegs, der in vertikaler Richtung, d.h. in die Tiefe eines Halbleitersubstrats 10 (Fig. 2) hinein ausgebildet ist. Von oben nach unten weist der Steg einen n^+ -Sourcebereich 1, einen einen n-Kanal bildenden p-Bereich 2, einen unverarmten p-Bereich oder Bulkbereich 4 und einen n^+ -Drainelektrodenbereich 3 auf. Gateelektrodenstreifen 5 umgeben rings den den n-Kanal bildenden p-Bereich 2 unter Zwischenlage einer in Fig. 1 nicht gezeigten dünnen Isolierschicht, so dass die Gateelektrodenstreifen 5 den n^+ -Sourcebereich 1 und den n^+ -Drainbereich 3 isoliert etwas überlappen.

Der diesen vertikalen FET-Transistor bildende Abschnitt des Stegs hat eine Länge $L = 2-3 F$ und eine Dicke d zwischen 0,5 und etwa 1 F, wobei z.B. F 70 nm oder kleiner sein kann. Isolierende Abschnitte 8 und 9 sind in Fig. 1 punktiert dargestellt. Fig. 1 zeigt auch einen Abschnitt eines tiefen Grabens (deep trench), in dem ein Speicherkondensator ausgebildet ist, der durch eine Kondensatorelektrode 6 und ein isolierendes Dielektrikum 9 veranschaulicht ist. Die Kondensatorelektrode 6 des Speicherkondensators, die zum Beispiel aus Polysilizium oder einem geeigneten Metall besteht, steht über einen leitenden Abschnitt 7 mit der n^+ -Drainelektrode 3 in Kontakt.

Fig. 2 zeigt einen Querschnitt der in Fig. 1 perspektivisch
gezeigten FET-Transistorstruktur durch den die aktiven Halb-
leiterbereiche bildenden aktiven Steg, wobei zwei benachbarte
vertikale FET-Transistoren ersichtlich sind. In Fig. 2 ist
5 deutlich zu erkennen, dass die durch die tiefen Gräben gebil-
deten Speicherkondensatoren bis tief in das Substrat 10 hin-
einreichen, um eine ausreichende Kapazität zu erzeugen. Fig.
2 zeigt ferner isolierende Oxidschichten 8, 8a, 8b jeweils
zwischen stirnseitigen Abschnitten 5a der umlaufenden Gatee-
10 lektrodenstreifen 5 und dem den n-Kanal bildenden p-Bereich 2
und der Drainelektrode 3 einerseits und zu dem leitenden
Kondensatorelektrodenabschnitt 6 andererseits.

Fig. 3 schließlich zeigt schematisch eine Layoutansicht der
15 in Fig. 2 gezeigten Struktur, die die parallele Anordnung der
aktiven Stege (von oben durch die n^+ -Sourceelektrodenbereiche
1 veranschaulicht) sowie die versetzte Anordnung der vertika-
len FET-Transistoren in den aktiven Stegen einerseits und der
zwischen jedem Transistor ausgebildeten Speicherkondensatoren
20 andererseits, veranschaulicht durch die tiefen Gräben 9 an-
deutende Ovale, zeigt.

Prinzipiell kann der die Wortleitung bildende Gateelektro-
denstreifen 5 durch so genannte CS-Kontakte bzw. Wortlei-
25 tungskontakte an jeder Stelle des Stegs kontaktiert werden.
Aus den Fig. 2 und 3 ersieht man jedoch deutlich, dass die
Herstellung einer zufrieden stellenden und dauerhaften Isola-
tion zwischen derartig platzierten Wortleitungs- bzw. CS-
Kontakten und aktivem Steg nicht gelingt. Die Wortleitungen
30 und die Wortleitungskontakte müssen außer von dem aktiven
Steg auch von eventuell ausgedehnten Bereichen der Speicher-
zellenanordnung isoliert sein. Weiterhin soll die Kapazität
von der Wortleitung bzw. dem Wortleitungskontakt zum aktiven
Steg und zu allem, was mit dem Steg verbunden ist, möglichst
35 klein gehalten werden. Es ist zu bemerken, dass prinzipiell

Drainelektrode 3 und Sourceelektrode 1 elektrisch austauschbar sind.

5 Ferner sollen an die Wortleitung Spannungen (z.B. negative Spannungen) angelegt werden können, die sich von den sonstigen Spannungen an der Speicherzelle unterscheiden.

10 Nachstehend werden erfindungsgemäße Strukturen beschrieben, die die obigen Probleme lösen und die kapazitätsarme und gegenüber den anderen Bereichen der Anordnung sicher elektrisch isolierte Wortleitungskontakte so schaffen, dass diese problemlos mit einer darüber liegenden Metallisierungsebene verbunden werden können. Erst mit dieser Isolierung können an die Wortleitungen negative Spannungen angelegt werden.

15 In den Fig. 4A und 4B ist jeweils in Form einer schematischen Layoutansicht und im Querschnitt ein Wortleitungskontakt 15 gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Transistorarrays dargestellt. Die Layoutansicht in Fig. 20 4A zeigt eine Metallebene 12 (M0), die gemäß Fig. 4B oberhalb der Ebene der Layoutansicht von Fig. 4A geschlossen und mit einem Wortleitungskontakt 15 verbunden ist und die oberste dargestellte Lage bildet, drei parallele aktive Stege (AT) 13, zu beiden Seiten der aktiven Stege 13 verlaufende, die 25 Wortleitungen bildende Gatestreifen 5 sowie als abwechselnd stark und schwach schräg schraffierte Flächen dargestellte tiefe Gräben 11, die so unter den Wortleitungskontakten 15 sitzen, dass sie einerseits die Kontaktierung der Wortleitungskontakte bzw. CS-Kontakte 15 mit den Wortleitungen 5 30 ermöglichen und andererseits die Wortleitungskontakte 15 von den übrigen Elementen isolieren.

Die Querschnittsdarstellung der Fig. 4B, die den Prozess wiedergibt und der Schnittlinie B-B in Fig. 4A entspricht, 35 zeigt, dass der Wortleitungskontakt 15 seitlich und unten durch Oxid am oberen Ende des tiefen Grabens 11 vom Steg 13

isoliert ist. Statt Oxid kann alternativ auch komplett Polysilizium verwendet werden, wobei dann die Isolation durch Deckoxid hergestellt ist, das den tiefen Graben 6, 9 bedeckt.

5 Es muss hier in Bezug auf die obige Beschreibung der Fig. 4A und 4B bemerkt werden, dass in dem Abschnitt des aktiven Stegs 13, der durch den erfindungsgemäß gestalteten Wortleitungskontakt 15 mit der Metallebene 12 verbunden ist, der in den Fig. 1 und 2 gezeigte und in der oben erläuterten Weise
10 in dem tiefen Graben gebildete Speicherkondensator 6, 9 nicht als solcher fungiert, da hier der nur im Speicherzellenfeld vorhandene vergrabene Anschluss (3 in Fig. 2) des aktiven Stegs mit dem tief liegenden Polysilizium weggelassen ist. Fig. 4B deutet lediglich schematisch einen Abschnitt des hier
15 funktionslosen Speicherkondensators an, der durch die Polysiliziumssäule 6 und deren Isolation 9 angedeutet ist. D.h., dass die Prozessschritte zur Bildung des Drainkontaktes mittels des vergrabenen Anschlusses bei diesem beim Wortleitungskontakt nur für Isolationszwecke gebrauchten tiefen
20 Graben weggelassen werden, dass aber die sonstigen Prozessschritte dieselben sind, wie beim Aufbau des tiefen Grabens im Speicherzellenfeld.

Fig. 5 zeigt in Form einer Layoutansicht ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Transistorarrays in Verbindung mit einem Speicherzellenarray 30. Alle Wortleitungs- bzw. CS-Kontakte 15 liegen in einer separaten p-Wanne 22, die von der p-Wanne 20, in der das Speicherzellenarray 30 liegt, räumlich und elektrisch getrennt ist. Die beiden p-
25 Wannen 20 und 22 sind in einer vergrabenen n-Platte 21 eingebettet und untereinander durch einen n-leitenden Bereich getrennt. Oxidgekapselte oder alternativ oxidgefüllte Säulen in durch die Stege 13 gehenden tiefen Gräben 11 stellen an der Schnittstelle der n-Platte 21 zur p-Wanne 22 die Isolati-
30 on zwischen den Stegen 13 innerhalb der Wanne 22 und außer-
35

halb her. Mit diesen tiefen Gräben 11 sind keine vergrabenen Anschlüsse verbunden.

Zusammengefasst lässt sich mit den in den Fig. 4A und 4B einerseits und in Fig. 5 andererseits dargestellten beiden Ausführungsbeispielen eines erfindungsgemäßen Transistorarrays eine gegenüber den anderen Elementen isolierte Kontaktierung der Wortleitungen mit einer darüber liegenden Metallebene M0 vorteilhaft so herstellen, dass

10

1) elektrischer Kontakt zwischen den Wortleitungen und den sie tragenden Stegen und allem, was mit den Stegen verbunden ist, vermieden wird;

15

2) die Kapazität zwischen den Wortleitungen und den sie tragenden Stegen und allem, was mit den Stegen verbunden ist, klein gehalten werden kann, und

20

3) an die Wortleitungen andere Spannungen (z.B. negative Spannungen) angelegt werden können, als an die sonstigen Elemente des Transistorarrays bzw. des diesem zugeordneten Speicherzellenarrays.

25

Patentansprüche

1. Transistorarray aus vertikalen FET-Transistoren (T), die jeweils in Form vertikaler und in Lateralrichtung parallel
5 laufender Abschnitte von aktiven Stegen (13) aus Halbleiterbereichen in die Tiefe eines Substrats ausgebildet sind und bei denen ein Kanalbereich (2) von einer Gateelektrode bildenden Gatestreifen (5) umgeben ist, die entlang den aktiven Stegabschnitten (13) laufen und gleichzeitig Wortleitungen
10 für ein dem Transistorarray zugeordnetes Array (30) aus Halbleiterspeicherzellen bilden, wobei Wortleitungskontakte (15), wenigstens einen Teil der Wortleitungen (5) elektrisch mit Metallbahnen einer das Transistorarray überlagernden Metallebene (M0) verbinden,
15 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die Wortleitungskontakte (15) jeweils durch eine in einem in die Tiefe des aktiven Stegs (13) gehenden tiefen Graben (11) vorgesehene Isolation gegenüber den anderen Elementen isoliert sind, wobei die tiefen Gräben (11) mit der-
20 selben Struktur gebildet sind, wie die tiefen Gräben, die sonst Speicherkondensatoren im Array (30) der Halbleiterspeicherzellen bilden mit Ausnahme eines vergrabenen Anschlusses, der den aktiven Steg im Speicherzellenarray (30) mit in der Tiefe des Substrats liegendem Polysilizium verbindet und der
25 in den tiefen Gräben (11) der Wortleitungskontakte (15) weggelassen ist.

2. Transistorarray nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
30 dass der tiefe Graben (11) unter dem Wortleitungskontakt (15) mit Isoliermaterial gefüllt ist.

3. Transistorarray aus vertikalen FET-Transistoren (T), die jeweils in Form vertikaler und in Lateralrichtung parallel
35 laufender Abschnitte von aktiven Stegen (13) aus Halbleiterbereichen in die Tiefe eines Substrats ausgebildet sind und

bei denen ein Kanalbereich (2) von einer Gateelektrode bilden-
den Gatestreifen (5) umgeben ist, die entlang den aktiven
Stegabschnitten (13) laufen und gleichzeitig Wortleitungen
für ein dem Transistorarray zugeordnetes Array (30) aus Halb-
5 leiter-speicherzellen bilden, wobei Wortleitungskontakte (15),
wenigstens einen Teil der Wortleitungen (5) elektrisch mit
Metallbahnen einer das Transistorarray überlagernden Metall-
ebene (M0) verbinden, und wobei das Transistorarray mit dem
Array (30) der Halbleiterspeicherzellen in einer gemeinsamen
10 ersten Halbleiterwanne (20) eines ersten Leitungstyps (P) in
dem Substrat angeordnet sind,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass alle Wortleitungen (5) mit den Wortleitungskontakten
(15) zur Metallebene (M0) in eine von der ersten Halbleiter-
15 wanne (20) isolierte separate zweite Halbleiterwanne (22)
desselben Leitungstyps (P) führen, und dort durch die Wort-
leitungskontakte (5) mit den Metallbahnen der Metallebene
(M0) in Kontakt stehen.

20 4. Transistorarray nach Anspruch 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die Wortleitungen (5) zu beiden Seiten tragenden
aktiven Stege (13) innerhalb der zweiten Halbleiterwanne (22)
von den entsprechenden Stegabschnitten außerhalb dieser zwei-
25 ten Halbleiterwanne (22) durch isolierende Säulen (23) inner-
halb von durch die Stege (13) gehenden tiefen Gräben (11) an
der Schnittstelle der zweiten Halbleiterwanne (22) zu einem
sie umgebenden Halbleiterbereich (21) des zweiten Leitungs-
typs (N) isoliert sind, wobei die tiefen Gräben (11) mit
30 derselben Struktur gebildet sind, wie die tiefen Gräben, die
sonst Speicherkondensatoren im Array (30) der Halbleiterspei-
cherzellen bilden mit Ausnahme eines vergrabenen Anschlusses,
der den aktiven Steg im Speicherzellenarray mit in der Tiefe
des Substrats liegendem Polysilizium verbindet und der in den
35 tiefen Gräben (11) an der Schnittstelle der zweiten Halblei-

terwanne (22) zu dem sie umgebenden Halbleiterbereich (21) weggelassen ist.

5 5. Transistorarray nach einem der vorangehenden Ansprüche,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die FET-Transistoren (T) n-Kanal-Transistoren (1, 2, 3)
sind, die Dicke (d) der die Halbleiterbereiche (1, 2, 3)
bildenden Stege 0,5 - 1 F, die Länge (l) jedes einen FET-
10 Transistor (T) bildenden Abschnitts der Stege 2-3 F, die
Dicke der Wortleitungen (5) annähernd 0,2 F und ihre vertika-
le Tiefe annähernd 5 F betragen, wobei F annähernd gleich 70
nm ist.

15 6. Transistorarray nach Anspruch 5,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die erste und zweite Halbleiterwanne (20, 22) vom P-Typ
sind.

20 7. Halbleiterspeicheranordnung,
g e k e n n z e i c h n e t d u r c h
ein FET-Transistorarray nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei jeder Speicherzelle des Speicherarrays je ein vertika-
ler FET-Transistor zugeordnet ist.

25 8. Halbleiterspeicheranordnung nach Anspruch 7,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass sie einen DRAM-Speicher bildet.

Zusammenfassung

Transistorarray und damit hergestellte Halbleiterspeicheranordnung

5

Ein erfindungsgemäßes Transistorarray besteht aus vertikalen FET-Transistoren, die jeweils mit einem Speicherkondensator eines Speicherzellenarrays verbunden sind. Wortleitungen (5) bildende Gateelektrodenstreifen der Transistoren liegen zu beiden Seiten von zueinander parallel laufenden aktiven Stegen (13) und sind durch Wortleitungs- bzw. CS-Kontakte (15) mit einer überlagernden Metallebene (12) verbunden. Um diese Wortleitungskontakte (15) gegenüber den anderen Elementen des Transistorarrays und des Zellenfeldes zu isolieren, liegen die Wortleitungskontakte (15) in in die Stege (13) eingebrachten tiefen Gräben (11).

10

15

20

25

Bei einer alternativen Ausführungsform liegen die die Wortleitung mit der Metallebene verbindenden Wortleitungskontakte in einer von der Wanne, in der das Speicherzellenarray liegt, separaten isolierten Wanne, und die die Wortleitungskontakte aufweisenden aktiven Stege, die in diese separate Wanne geführt sind, sind von dem umgebenden Gebiet durch an der Schnittstelle liegende isolierende tiefe Gräben (11) isoliert.

(Fig. 4A)

Bezugszeichenliste

1	Sourceelektrodenbereich
2	Kanalzone
3	Drainelektrode
4	Bulk
5, 5a	Gateelektrodenstreifen
6	Polysiliziumsäule
7	Kontaktierung der Sourceelektrode 3 mit der Polysiliziumsäule 6
8, 8a, 8b, 9	Isolation/Dielektrikum
10	Substrat
T	vertikaler FET-Transistor
11	tiefer Graben
13	aktive Stege (AT)
15	Wortleitungs- bzw. CS-Kontakt
17	Isolation
20, 22	isolierte p-Wannen
21	vergrabene n-Platte
30	Speicherzellenarray
AT	aktiver Steg
M0	Metallebene
WL	Wortleitung

FIG 2 Schnitt A-A

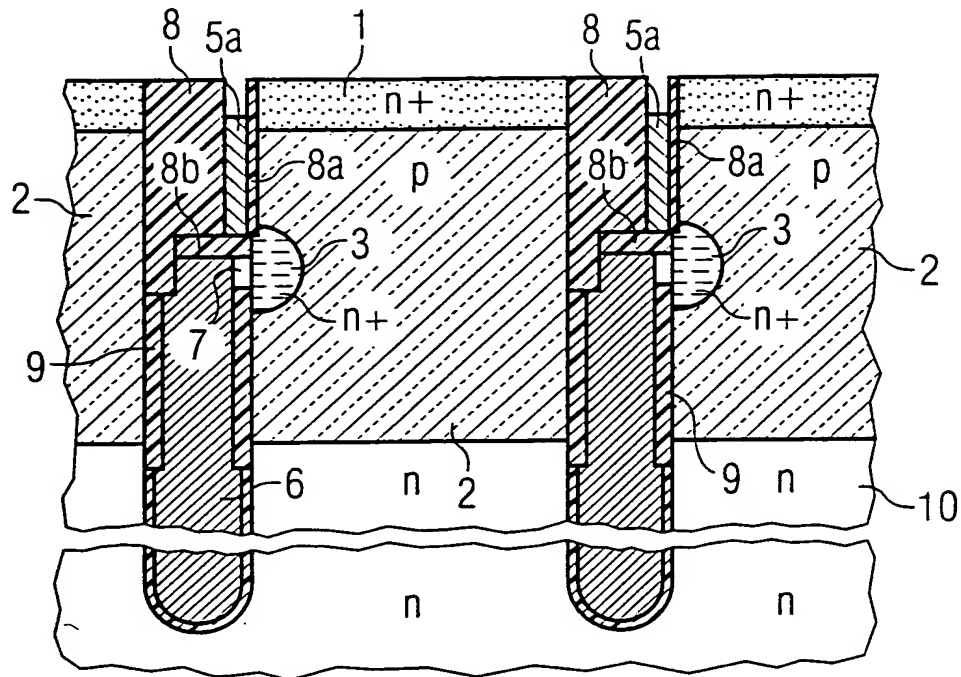
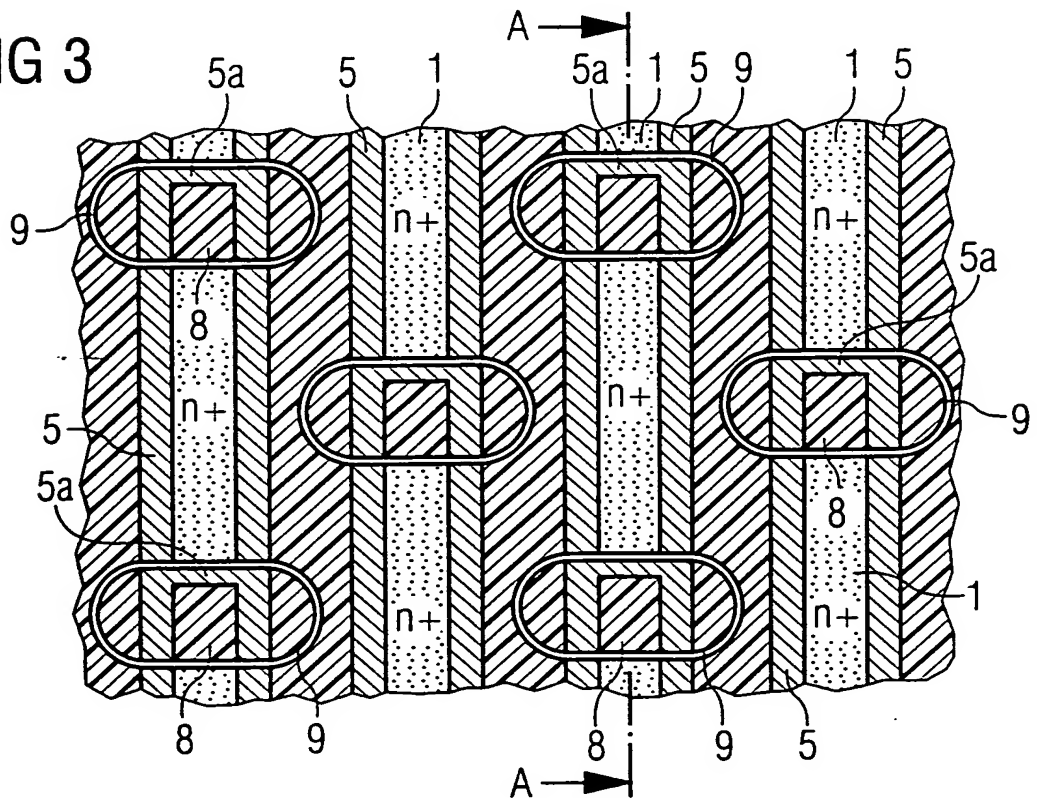


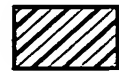
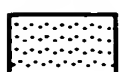
FIG 3



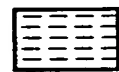
Gate



p-Bereich

Isolation/
DielektrikumStege (AT)
(Source-Bereich)

Poly-Si



Drain-Bereich

FIG 4A

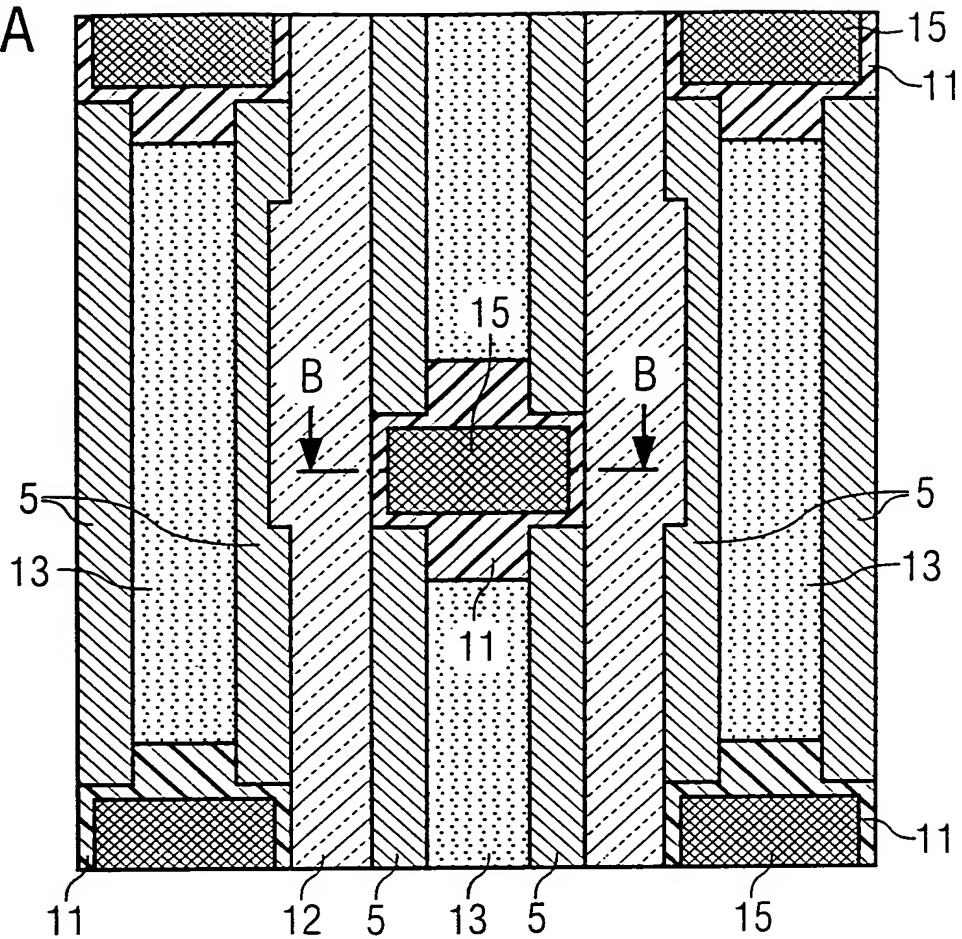
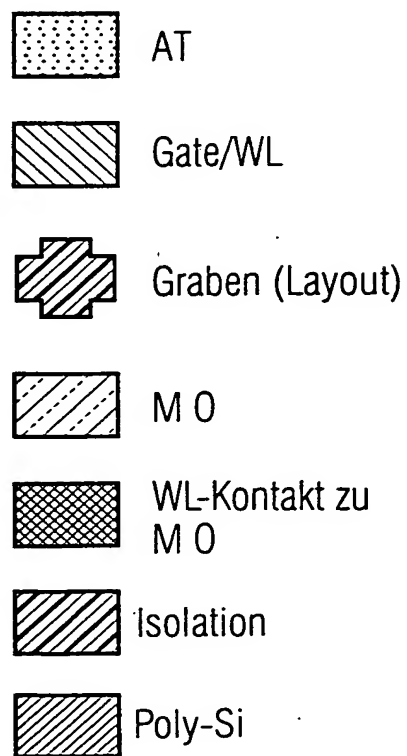
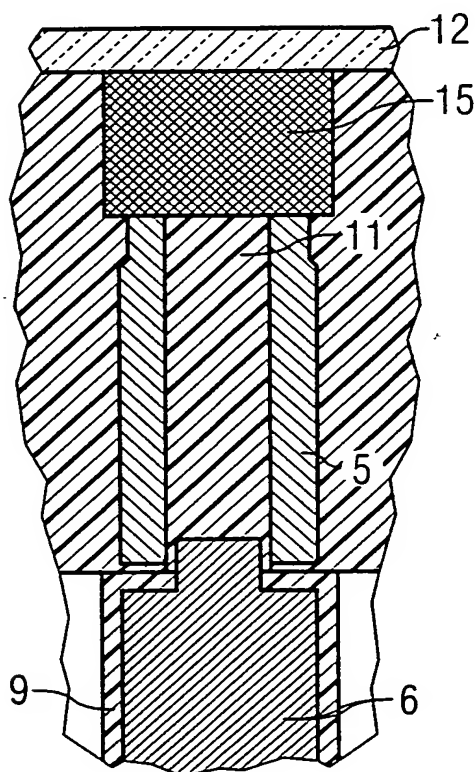


FIG 4B

Schnitt B-B



Figur für die Zusammenfassung

FIG 4A

